

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展暨“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）和2025年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-030）。

2025年度，公司从持续聚焦主业、以创新驱动高质量发展、持续加大研发投入、不断完善公司治理、强化规范运作、提升信息披露质量和保持稳健现金分红等方面采取措施，切实推动“质量回报双提升”，现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、专注主业发展，深耕功率半导体

公司紧跟下游新市场新领域的发展契机，聚焦新兴市场的增长机会，重点拓展汽车电子、储能、风能、AI数据中心、具身智能、低空经济等新兴行业的TOP客户，发挥IDM和一站式产品解决方案的核心优势，实现了行业TOP大客户全覆盖，构建了“客户需求-技术响应-闭环改进”的敏捷服务体系。同时，公司设立专职战略好产品行销经理，重点推广MOSFET、IGBT、SiC系列产品，进行战略好产品的销售和推广赋能，形成团队作战模式，帮助销售获得产品承认机

会，加速商机转化率，提高重点产品销售占比。报告期内汽车电子行业业绩大幅增长，公司全年营收收入达 71.30 亿元，同比上升 18.18%。

随着经营规模的持续扩大，公司正加速向集团化、国际化迈进，持续推进国际化战略布局，加强海外市场与国内市场的双向联动，实现多元化产品的全球市场渠道覆盖，同时持续推进国内外电商业务模式，线下和线上相结合，进一步强化品牌建设，提升品牌国际影响力。目前，公司在全球 50 多个国家/地区设立了在地化研发、制造与销售网络，其中研发中心 7 个，能够紧扣本土客户的定制化需求，将全球最佳实践经验融入本土化产品开发。2025 年，公司首个海外车规级封装基地 MCC(越南)工厂已量产，并在越南基地投资建设首座车规级 6 吋晶圆工厂，首条车规级 SiC 芯片产线顺利实现量产爬坡，首条 SiC 车规级功率半导体模块封装项目建成并投产，获得多家国际、国内主流 Tier1 客户订单。

依托综合营收规模、技术研发实力及市场占有率等核心指标，公司再度蝉联由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强，OMDIA 全球功率半导体 discrete 榜单排名第八，位列国内外多个半导体企业榜单前二十强、工信部汽车白名单等。2025 年，公司取得多家国际标杆汽车整车厂和 Tier1 客户认证，技术方案和产品性能获得多家主流客户认可；相继斩获全国首张芯片国产化权威认证、中国 SiC 器件 IDM 十强企业等行业荣誉，行业影响力与品牌认可度持续提升。

二、坚持创新驱动，加速国产化进程

公司积极深化与多所知名院校及科研院所的产学研合作，坚持外部引进和内生培养并举的人才战略，在实现公司技术快速迭代的同时保持自身企业文化的传承。外引方面，公司持续引进国内外资深技术人才，形成了一支覆盖高端芯片研发设计、先进功率半导体晶圆制造、先进封装研发设计等各方面的高质量人才队伍，整合各个事业部的研发资源，构建了组织层次分明、分工协作清晰的综合化研发体系。

公司在扬州总部设有中央研究院，负责开展前沿技术、基础研究及实验室建设运营，统筹管理全公司研发项目。各事业部和产品线设有产品研发部门（包括 SiC 研发团队、IGBT 研发团队、MOSFET 研发团队等），紧密围绕客户需求及市

场趋势对具体产品进行研究开发和量产导入，形成“开发一代、储备一代、研究一代”的产品开发管理体系。同时，公司持续完善研发体系，贯彻 IPD 体系落地，引入业界最优研发流程 PLM（产品全生命周期管理系统）优化落地执行，完善研发基础数据库构建与研发专业知识管理平台搭建，为持续高效的研发产出夯实系统基础。

报告期内，公司持续增加对第三代半导体芯片行业的投入，加大在以 SiC 为代表的第三代半导体功率器件等产品的研发力度，以进一步满足公司后续战略发展需求，在 SiC、IGBT、MOSFET 产品布局、设计、制造工艺等关键环节不断实现突破，已形成多电压平台协同推进、车规认证持续落地、核心性能指标领先市场的技术驱动型成长路径。

截至 2025 年末，公司累计获授知识产权 716 件，其中发明 132 件、实用新型 492 件、集成电路布图设计 70 件、软件著作权 9 件、外观设计 13 件。作为功率半导体领域标准的主要起草单位之一，参与了国标《半导体分立器件第 1 部分：分规范》（计划号：20233151-T-339）和《半导体分立器件第 2 部分：分立器件整流二极管》（计划号：20232773-T-339）及团标《半导体芯片封装用导电胶性能要求及测试方法》《光伏组件接线盒用模块二极管》《半导体封装用 UV 减黏保护膜性能要求及测试方法》的编制与修订。

三、完善公司治理，强化规范运作

公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等制度要求，已建立、健全了法人治理结构并规范运作，具备完善的股东会、董事会和管理层独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

为进一步优化治理结构，2025 年增选徐小兵先生为公司第五届董事会职工代表董事并取消监事会，提高董事会决策的科学性、有效性，使董事会构成更均衡、审计委员会职能更强化，提升治理效率。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成均符合有关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》等要求，董事会成员包含会计专业人士、业内专家和其它专业人士，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

公司严格规范股东会的召集、召开及表决程序，充分保障全体股东特别是中小股东的平等法律地位和合法权利。2025年，所有应由股东会审议的事项均严格履行审批权限与审议程序，不存在越权审批或先实施后审议的情形；共召开1次年度股东会及4次临时股东会，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，会议程序合法合规。

公司持续完善长效激励机制、夯实长期发展动能。公司于2025年5月30日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（六期）”员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

四、聚焦公司价值，提升信息披露质量

公司严格按照《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

公司尊重并保障所有股东作为公司所有者的权利，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等规定定期召集、召开股东会，确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项决策的参与。同时，2025年公司通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，持续完善投资者沟通渠道。公司已连续3年获深交所信息披露最高评级（A级）。

公司持续夯实法人治理架构，健全内部控制制度，修订完善管理制度规范公司日常经营管理，持续推动董事会、股东会规范高效运作，充分发挥各治理主体作用，切实提升合规风险管控实效。

五、保持稳健现金分红，落实股东回报

公司在 2025 年保持稳健的现金分红制度，为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来投资回报。

2025 年度，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式累计回购公司股份 870,100 股 A 股股票，回购金额为 40,983,874.00 元人民币（不含交易费用）。

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案：以截至 2025 年 8 月 18 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），合计派发现金股利 228,206,070.54 元（含税）。本次利润分配方案已于 2025 年 9 月 16 日实施完毕。

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟定 2025 年度利润分配预案：以截至 2026 年 3 月 28 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50 元（含税）。

公司致力于通过稳健经营不断提升公司内在价值，持续为股东创造长期投资价值，并通过现金分红方式，切实提升股东的获得感。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日